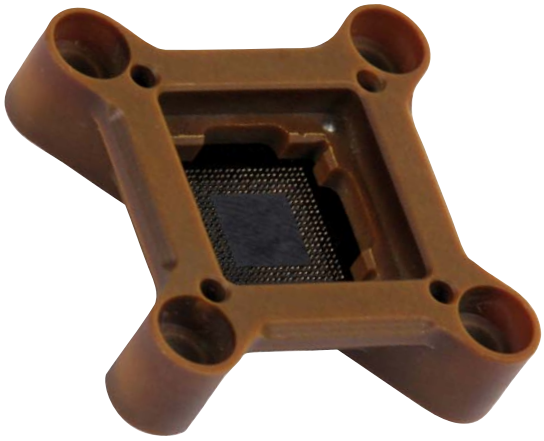
ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

HSIO technologies

BGA40



Высококачественные испытательные панельки для ИС

0.4 - 0.5 миллиметровые панельки, обеспечивающие устойчивое и надежное испытание высокочастотных компонентов и систем с высокой повторяемостью результатов

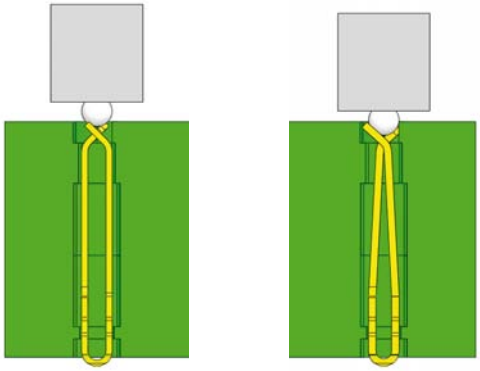
Компания HSIO Technologies разработала панельки тестирования BGA40 в строгом соответствии с требованиями к надежности высококачественного сигнала для тестирования высокочастотных компонентов и систем. Эти высококачественные, компактные разъемы тестирования приспособлены к широкому спектру стандартов и размеров корпуса, а также количеству вводов-выводов. Тестирование приборов в корпусе BGA при помощи специальных разъемов BGA40 обеспечивает успешное выполнение следующих задач:

- Разработка и определение характеристик
- Валидация платформы
- Системное соединение
- Экранирование устройств
- Разработка и оценка программного обеспечения
- Маркетинг и оценка печатных плат

ПРЕИМУЩЕСТВА

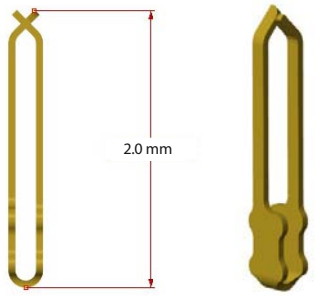
Надежность сигнала	Короткий путь прохождения сигнала способствует снижению коэффициента индукции, обеспечивая почти незаметное электрическое соединение.
Механическая прочность	Оксидная пленка защищает контакты от образования налета припоя и обеспечивает стабильное сопротивление перехода в паре шарик - контакт.
Взаимозаменяемость контактных групп	Использование разъемов с взаимозаменяемыми группами контактов значительно снижает затраты по сравнению с покупкой нового разъема.
Высокая эффективность по времени	Размещение пассивного компонента возле устройства, интегрированного в стандартный корпус разъема обеспечивает превосходные электрические характеристики при использовании стандартных конструкций и более короткие сроки подготовительных процессов при производстве.
Универсальность и экономическая эффективность	Испытательные панельки BGA40 спроектированы с учетом существующих требований к надежности, высокому качеству и эффективности для большинства требуемых устройств, платформ и системных приложений.

МЕТОДОЛОГИЯ



Тестовая площадка в разрезе

КОНТАКТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сигнальная характеристика	Миниатюрные штампованные выводы типа BeCu обеспечивают сверхкороткий путь
Срезающее-протирочное действие по окислу	Вывод BGA40 имеет острые кромки для прорезывания оксидной пленки на поверхности шарика из припоя.
Контактные группы и контакты	Возможность легкой замены групп вывода, а также отдельных выводов в полевых условиях.
Разъединение вблизи устройства	Мелкие шаги сетки наряду с крупными гнездами разрыва, спроектированные для корпусов стандартных размеров, позволяют размещать пассивные компоненты вблизи устройства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ	Шаг 0.4 мм	Шаг 0.5 мм
Время задержки	11.3 пс	10.5 пс
Собственная индуктивность	0.55 нГ	0.52нГ
Взаимная индуктивность	0.106 нГ	0.102 нГ
Ёмкость при заземлении	0.239 пФ	0.244 пФ
Взаимная ёмкость	0.058 пФ	0.026 пФ
Вносимые потери -1 дБ	38.1 ГГц	40 ГГц
Импеданс	40.7Ω	51.7Ω

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сила тока	2.5 А (свободный воздух)
Контактное сопротивление	<25 миллиом
Срок службы контакта	15000 вставок
Нормальное усилие	30-40 грамм/контакт
Вертикальное сжатие	0.15 мм

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал изготовления контакта и покрытие	Медный сплав (Cu) Золото (Au) поверх никеля (Ni)
Высота контакта	2 мм
Корпус	Полиимид (Cirlex®)
Каркас	Torlon® 5030, Ultem® 2300 или равноценное
Условия эксплуатации	-40°C - 150°C (-40°F - 302°F)

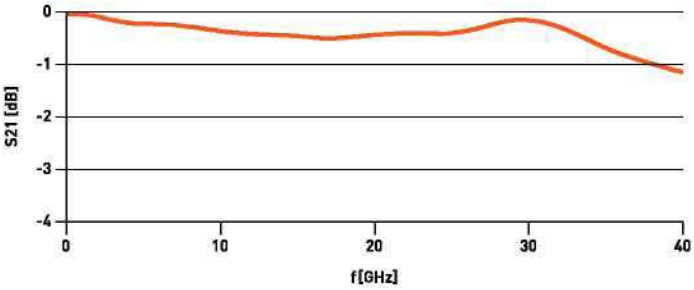
Технические параметры могут отличаться в зависимости от приложения и требований о соответствии. По запросу возможно предоставление дополнительной информации.

Технические характеристики панели

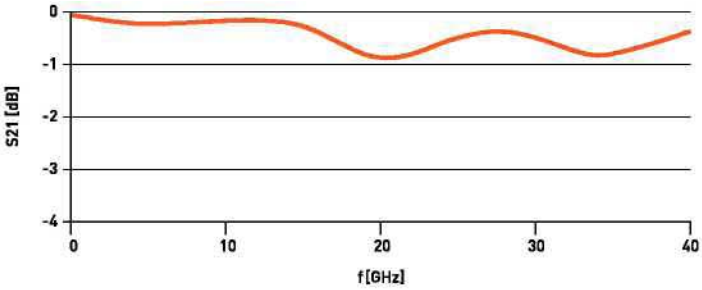
Обладая шагом 0.4 - 0.5 миллиметра, испытательные панельки BGA40 доступны для широкого диапазона примеров сетки, включая разработку заказных приборов. Уникальная конструкция контакта обеспечивает высокую точность передачи сигнала в современных высокочастотных применениях. Кроме того, каждый из этих разъемов тестирования спроектирован таким образом, чтобы минимизировать дорогостоящую полезную площадь печатной платы, обеспечивая предельно близкое размещение развязки и испытуемого устройства. Кроме того, заказчик может выбирать тип крышки разъема по своему усмотрению, включая болтовую, шарнирную или зажимную.

Вносимые потери

Шаг 0.4 мм



Шаг 0.5 мм



©Copyright2012.
HSIO Technologies,LLC/ All right reserved/ Data subject to change without notice HSIO Technologies, LLC/13300 67th Avenue North, Maple Grove, MN 55311 USA. +1.763.447.6260/ Sales@HSIOTech.com/ www.HSIOTech.com

ЗАО «ЭлекТрейд-М»
Россия, 115404, г.Москва,
11-я Радиальная ул., д.2,офис 20
Тел./Факс: +7.499.218.2360 /
info@eltm.ru / www.eltm.ru